MENU SEARCH INDEX DETAIL JAPANESE

1/1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-204493

(43) Date of publication of application: 13.08.1993

(51)Int.CI.

G06F 1/26

(21)Application number : **04**-106531

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

24.04.1992

(72)Inventor: FUJITA TAKASHI

MAEDA TAKASHI

(30)Priority

Priority number: 03312370

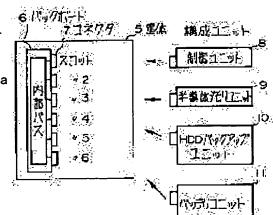
Priority date: 27.11.1991

Priority country: JP

(54) RECORDER AND ELECTRONIC EQUIPMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a semiconductor disk device which can be extended so that various units can be connected at an optional position via an inside bus and that an optional semiconductor disk system fitted to a using purpose can be composed in a single device. CONSTITUTION: Plural connectors 7 of a same shape which are connected on a back board 6 are provided and the signal of the respective connectors is set to be common so that a control unit 8, a semiconductor memory unit 9, an HDD backup unit 10 and a battery unit 11 can selectively connected at the optional position of the connectors 7. Thus, inside unit constitution is freely selected/connected so that various systems can be constituted in the single device.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-204493

(43)公開日 平成5年(1993)8月13日

(51) Int.Cl.5

識別記号

FΙ

技術表示箇所

G06F 1/26

7165-5B

庁内整理番号

G06F 1/00

330 A

審査請求 未請求 請求項の数2(全 9 頁)

(21)出願番号

特願平4-106531

(22)出願日

平成4年(1992)4月24日

(31)優先権主張番号 特願平3-312370

(32)優先日

平3 (1991)11月27日

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(71)出願人 000006013

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(72) 発明者 藤田 隆

鎌倉市上町屋325番地 三菱電機株式会社

コンピュータ製作所内

(72)発明者 前田 隆司

鎌倉市上町屋325番地 三菱電機株式会社

コンピュータ製作所内

(74)代理人 弁理士 高田 守

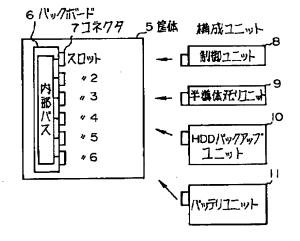
(54) 【発明の名称】 記録装置及び電子機器

(57)【要約】

【目的】 種々のユニットが内部バスを介して任意の位置に接続でき、使用目的に合わせた任意の半導体ディスクシステムを1台の装置の中で構築できるように拡張性を持たせた半導体ディスク装置を提供する。

【構成】 バックボード6上に接続された複数の同一形状のコネクタ7を備え、各コネクタ7の信号を共通にして、任意のコネクタ7位置に、制御ユニット8、半導体メモリユニット9、HDDパックアップユニット10、パッテリユニット11を選択的に接続できるように構成した。

【効果】 内部ユニット構成を自由に選択接続することで、1台で種々のシステムを構成できる。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 以下の要素を有する記録装置(a)共通 のバスとその共通のバスに接続された複数のコネクタを 備えたボード、(b)上記ボードの複数のコネクタの中 の任意のコネクタに接続され、他のコネクタに接続され るユニットを制御する制御ユニット、(c)少なくと も、以下のユニットのいずれかひとつ以上から構成さ れ、上記制御ユニットが接続されたコネクタ以外の他の 任意のコネクタに接続される被制御ユニット、

(c1) 揮発性記録媒体にデータを記憶する揮発性記録 ユニット、

(c2) 不揮発性記憶媒体にデータを記憶する不揮発性 記録ユニット、

(c3) 電力を供給する電力供給ユニット。

【請求項2】 以下の要素を有する電子機器(a)所定 の動作を行なう動作部、(b)上記動作部の一部をおお う筐体、(c)平形のパッテリを収容して上記動作部の 他部をおおうように上記管体にとりつけられ、上記動作 部に対して電力を供給する電力供給ユニット。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、記録装置及び電子機 器に関し、たとえば、内部パスに種々のユニットを混在 接続させ拡張性を持たせたことを特徴とした半導体ディ スク装置、あるいは、バッテリユニットを筐体の一部に 兼用して用いることを特徴とした半導体ディスク装置に 関するものである。

[0002]

【従来の技術】

公報に示された従来のデータバックアップ機構を内蔵さ せた半導体ディスク装置の構成図、図11は同じ装置の 回路プロック図を示す図であり、図において1は半導体 メモリ、2は3.5吋磁気ディスク装置、3はパッテ リ、4は周辺回路部であって、これら全体が5の筐体に 収納されている。

【0003】動作について説明する。電源が投入される と3. 5 吋磁気ディスク装置2のデータを周辺回路部4 を経由して半導体メモリ1上へ書き込む。このデータに 対してリードライト動作が行われる。電源断時はパッテ リ3から3.5吋磁気ディスク装置2及び半導体メモリ 1へ電源供給を行い、半導体メモリ1のデータを周辺回 路部4を経由して3.5吋磁気ディスク装置2へ退避さ せる。

【0004】従来例2. また、図12は従来のデータバ ックアップ機構を内蔵させた半導体ディスク装置の他の 構成図である。図において、5は半導体ディスク装置の 筐体、11はパッテリユニット、26はパッテリユニッ ト11内に内蔵された電池、28は半導体ディスク装置

接続ケーブルである。この例においては半導体ディスク 装置自身とその半導体ディスク装置に電力を供給するバ ッテリは別々の筐体で構成されている。

【0005】従来例3. また、図13は従来の半導体デ ィスク装置の構成図を示す図である。図において、23 は外部からの電源を接続するための外部電源供給コネク タ、25はバッテリユニット11側に設けられた係合コ ネクタ、28は筐体側に設けられた係合コネクタ、26 はバッテリユニット11の内部に設けられた電池、27 は半導体ディスク装置の内部に設けられた実装部品であ る。この例においては、筐体5の内部にバッテリユニッ ト11を内蔵しており、パッテリ側の係合コネクタ25 と本体側の係合コネクタ28がそれぞれ係合されること によりパッテリユニット11から本体に対して電力を供 給することが可能となっている。

【0006】従来例4. また、図14は半導体ディスク 装置の構成図を示しており、図において、26は小型の 円形電池、28は実装部品27の上に設けられた円形電 池26と係合するための係合コネクタである。この例に 20 おいては、実装部品27の上に直接電池を搭載する例を 示している。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】従来のデータバックア ップ機構を内蔵させた半導体ディスク装置は以上のよう に構成されているので、装置の構成要素として磁気ディ スク装置、半導体メモリ、周辺回路部、パッテリを全て 筺体内部に持つ必要があり、構成要素の種類、容量、大 きさ、数量、取付位置が固定されているため、各構成要 素を任意選択的に実装して使用するということができな 従来例1. 図10は例えば特開昭63-100555号 30 いという問題点がある。また、従来の半導体ディスク装 置はデータバックアップ機構を持つためにバッテリを備 えており、このパッテリを実装するための空間を半導体 ディスク装置内部あるいは半導体ディスク装置の外部に 持つことが必要になり、パッテリを設けることにより半 導体ディスク装置内部の空間が制限されたり、あるいは 外部に特別のパッテリ装置を設けなければならないとい う問題点がある。

> 【0008】第1の発明は上記のような問題点を解消す るためになされたもので、使用目的に合わせた任意の構 成のシステムを1台の装置の中で構築できるように拡張 性を持たせた記録装置を提供することを目的とする。ま た第2の発明は上記のような問題点を解消するためにな されたもので、パッテリユニットを効率よく電子機器に 配置することにより他の実装部品に及ぼす影響を少なく した電子機器を提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】第1の発明に係る記録装 置は、装置内の内部バスに各種のユニットが混在接続可 能となるように構成したものであり、たとえば、装置内 5 とパッテリユニット11を接続するパッテリユニット *50* 共通内部パスに制御ユニット、半導体メモリユニット、

HDDバックアップユニット、バッテリユニットが任意 の位置に接続できるようにしたものである。

【0010】第2の発明に係る電子機器は、パッテリユ ニットをその電子機器が有する管体の一部に兼用して用 いるようにしたものである。例えば、電子機器のパック パネルの代わりに平板状のパッテリを取り付けることに より、そのパッテリ自身を筐体のパックパネルの代わり に用いるようにしたものである。

[0011]

【作用】第1の発明における記録装置は、共通の内部パ 10 スをもつバックボード上に複数のコネクタを実装し、各 コネクタ間のパス信号を共通にしたことで、ユニットの 接続位置、種類を限定することなく、任意な構成をとれ るようにしたものである。

【0012】第2の発明における電子機器は、その電子 機器の操作に必要な電力を筐体の一部に兼用されたパッ テリユニットから供給を受けて動作することが可能にな る。従って、筐体内部に実装される実装部品に与えるパ ッテリユニットの影響は極力避けることができ、電子機 器の実装部品を筐体の空間内に有効に配置することが可 20 能になる。

[0013]

【実施例】

実施例1.以下、第1のの発明の一実施例を図について 説明する。図1は装置構成図、図2は回路ブロック図、 図3はスロットのピン配置の一部を示した例、図4、図 5、図6は任意の構成が可能であることを示した例であ る。図において6はパックポード、7はコネクタ、8は 制御ユニット、9は半導体メモリユニット、10はHD Dバックアップユニット、11はバッテリユニット、1 2はマイクロプロセッサ、13はユニット識別回路、1 4はインタフェース回路、15は読みだし・書き込み回

【0014】図1にあるようにスロット1から6のコネ クタ7形状は同一で、信号も各スロット固有のユニット アドレス信号以外は全て共通となっている。制御ユニッ ト8はシステム構成上必須のユニットである。制御ユニ ット8のマイクロプロセッサ12からパス上に接続され ているユニットの数と種類をチェックし、記憶する動作 を装置起動時に実施する。

【0015】この動作について図3に示したスロットの ピン配置を参照しながら説明する。各スロットには固有 のアドレス番号が与えられており、そこに挿入されたユ ニットにユニットアドレス0~3を用いて4ピットのア ドレス番号が送出される。又、各ユニットにはその種類 を示す4ピットのユニットタイプが与えられている。マ イクロプロセッサ12から各スロットに対しユニットセ レクト0~3を用いてユニットセレクト信号を送出す る。そこに接続されているユニットはユニット識別回路

アドレス番号が一致した場合、ユニットタイプ線0~3 上に自分のユニットタイプを送出する。

【0016】マイクロプロセッサ12は、順次、アドレ ス番号を指定し、そのスロットに接続されているユニッ トの種類をパス上に送出されてきたユニットタイプ信号 によって認識し、装置の構成が決定される。

【0017】従って、図4の様にスロット2から6に半 導体メモリユニット9を接続した場合は大容量半導体デ ィスク装置として使用でき、図5の様にスロット2、3 に半導体メモリユニット9、スロット4にHDDパック アップユニット10を接続した場合にはデータの不揮発 化を目的としたHDDパックアップ機構付きの半導体デ ィスク装置として使用でき、図6の様にスロット2、 3、4に半導体メモリユニット9、スロット5にパッテ リユニット11を接続した場合には短時間の電源断に対 するデータ保全を目的とした電源パックアップ機構付き の半導体ディスク装置として使用できる。

【0018】装置の構成が決まると制御ユニット8は上 位装置に対してはインタフェース回路14により、内部 ユニットに対しては読みだし・書き込み回路15により データの転送を行う。この様に、スロット1から6には コネクタ形状とパス信号が一致すればどの様なユニット でも混在接続することができ、自由なシステム構成がと

【0019】以上のように、この実施例では、パックボ ード上に接続された複数の同一形状コネクタを備え、各 コネクタの信号をコネクタ位置に対応した固有のアドレ ス信号以外は共通とし、任意のコネクタ位置に、制御ユ ニット、半導体メモリユニット、パッテリユニット、H **DDパックアップユニットを選択的に接続できるように** 構成した半導体ディスク装置を説明した。

【0020】なお、上記実施例では使用しているスロッ ト数を6としたが、これは数に制限がない。また、ユニ ットは上記例の他、AC電源ユニット、FDDパックア ップユニット、あるいは、その他のユニットであっても よい。また、これら半導体メモリユニット、HDDパッ クアップユニット、バッテリユニットの容量、寸法には 制限がない。

【0021】この様な混在接続に関する先行技術として 40 は、特開平3-30007に示されるものがある。これ には、パーソナルコンピュータにおいてディスクドライ プユニット、半導体メモリユニットがコネクタに対して 互換可能な構造で接続できることを特徴とする技術が記 載されている。しかし、この先行技術の場合はコンピュ 一夕自身の発明であること、特定の位置にある専用スロ ットにのみ複数のパックアップ手段が同一インタフェー スで接続可能であること、混在接続ユニットとしては記 憶装置に限定されていることに対し、本発明は、コンピ ュータではなく記録装置の発明であること、複数のコネ 13によりユニットセレクト信号で指定したアドレスと 50 クタ (スロット) のいずれでも接続可能であること、混 5

在接続ユニットとして制御ユニットやバッテリユニット 等の記録装置以外のものまで含んでいることの理由で、 先行技術と本発明とは異なっている。

【0022】実施例2.以下、第2の発明の一実施例を 図について説明する。図7はこの発明に係る電子機器の 一例を半導体ディスク装置を用いて示した図であり、図 7 (a) は半導体ディスク装置の斜視図を示し、図7 (b) はその半導体ディスク装置に用いられるパッテリ ユニットの斜視図を示し、図7(c)は図7(a)にお けるA-A断面図を示している。図において、5は半導 体ディスク装置の筺体あるいは半導体ディスク装置本 体、11はパッテリユニット、23は外部から電源の供 給を受けるための外部電源供給コネクタ、24はバッテ リユニット11を筐体5に対して取り付けるためのパッ テリユニット固定用凸部、また25はパッテリユニット 11に設けられた係合コネクタ、26はパッテリユニッ ト11内部に設けられた薄板状の電池、27は筺体5内 部に設けられた半導体ディスク装置の実装部品、28は 半導体ディスク装置の本体側に設けられた係合コネクタ である。

【0023】この例では、本体内に実装されている揮発 性メモリーの電源パックアップ機構として背面カパーの 代わりにパッテリユニット11を装着することを特徴と している。このパッテリユニット11はパッテリユニッ ト固定用凸部24を有することにより、筐体5に設けら れた孔に対してこのパッテリユニット固定用凸部が係合 することにより容易に装着及び取り外しができるように なっている。また、パッテリユニットは係合コネクタ2 5を有しており、この係合コネクタ25は筐体5の内部 に設けられた、例えば、制御用の制御ユニット等の実装 30 部品27に設けられた本体側の係合コネクタ28と係合 することによりパッテリユニット内にある電力が本体に 対して供給されることになる。このバッテリユニットを 本体5に対して取り付ける場合には、まず係合コネクタ 25と係合コネクタ28を接続し、その後パッテリユニ ット固定用凸部24を筐体5にある孔に対して係合させ ることにより容易に装着することが可能となる。取り外 す場合においては、その逆の手順を行なうことにより、 同じく容易に取り外すことが可能となる。なお、この半 導体ディスク装置が振動のあるような場所で用いられる ような場合には、パッテリユニット11が筐体5から脱 落する恐れがあるため、このような場合には図示しない が筐体5とパッテリユニット11をネジ止め、あるい は、テープ止め、あるいは、接着止めなどを施してもか まわない。また、このパッテリユニットは本体に対して 電力を供給する場合ばかりでなく、本体側の外部電源供 給コネクタ23を介して電力を受け充電できるようなも のであってもかまわない。また、この半導体ディスク装 置がパッテリを使用しない場合においては、このパッテ

ニット11の代わりに同じく装着及び取り外しが容易にできるパックカパーを別に用意しておいてパッテリユニット11のかわりに装着してもかまわない。パッテリユニット11が装着されていない場合においては、この半導体ディスク装置は外部電源供給コネクタ23からの電力の供給のみによって動作する。

6

【0024】以上のようにこの実施例はバッテリユニット11が薄型あるいは板状の電池26を有しており、バッテリユニット11自身を板状に形成することが可能となり、この薄型に形成されたパッテリユニット11を筐体5の一部として用いる例を示した。

【0025】実施例3.次に、図8を用いてこの発明の 他の実施例について説明する。図8において、図7と同 一符号は同一または相当部分を示しておりその詳細な説 明を省略する。図8において、特に特徴となるところは パッテリユニット11の形状が単に平型あるいは板状の 形状をしているのではなく、L字形の形状を呈している ことにある。このL字型に形成されたパッテリユニット は、図8 (a) に示すように半導体ディスク装置の筐体 5に対して背面カバー及び側面カバーの両方を兼用する ことが可能となる。もし、図7に示したように背面カバ ーだけを兼用している場合では、電池の容量が足りない 場合があり、このような場合には図8に示したように側 面カバーを兼ねるようにバッテリユニット11を形成す ることにより電池の容量を2倍あるいは3倍に増やすこ とが可能となる。また、同様の考え方を用いると背面力 パー及び側面カパーのみではなく前面カパーあるいは上 面カバー、下面カバーをするようにしてもよい。こうす ることにより、筐体5のいずれの任意の面においてもバ ッテリユニット11で兼用することが可能である。

【0026】実施例4.次に、図9を用いてこの発明の他の実施例を更に説明する。図9において、図7に示した符号と同一符号は同一または相当部分を示しここではその説明を省略する。図9において、図7に示したものと異なることはパッテリユニット11が背面全体をカバーしているのではなく、この例では半分の部分をカバーしている点である。バッテリユニット11の容量がさほど必要ない場合にはパッテリユニット11のサイズを小さくすることにより、半導体ディスク装置の一つの面全てをパッテリユニット11で兼用する必要はなくなり、例えばこの例のように半分の部分をカバーするようなパッテリユニット11であってもかまわない。

が管体 5 とパッテリユニット 1 1 をネジ止め、あるいは、テープ止め、あるいは、接着止めなどを施してもかまわない。また、このパッテリユニットは本体に対して電力を供給する場合ばかりでなく、本体側の外部電源供給コネクタ 2 3 を介して電力を受け充電できるようなものであってもかまわない。また、この半導体ディスク装置がパッテリを使用しない場合においては、このパッテであってもかまわない場合においては、このパッテである。このように乾電池を電子機器の管体の底の部分に収りユニット 1 1 を装着している必要はなく、パッテリユ 50 納しているという部分においては、前記実施例と共通す

7

る点はみられるが、図15に示すように乾電池以外に底板60が存在しておりこの乾電池を収容するために底板を必要としている点で前述したこの発明の実施例とは異なるものである。

【0028】また、図16は従来の携帯用無線機器を示す図であり、図において、5は携帯用無線機の筐体、11はその筐体5に対して接続された電池ケースである。電池ケース11は矢印X方向にスライドさせ、また筐体5は矢印Yの方にスライドさせることにより両者を分離することが可能になっている。この例においては、電池10ケース11が携帯用無線機の筐体5の底部に存在しておりこの点ではこの発明の前述した実施例と共通しているが、電池ケース11自身が携帯用無線機の表面、裏面、側面等を形成しており、この電池ケースによって形成された表面、裏面、側面の内部全てが電池である点で前述した実施例とは異なっているものである。

【0029】また、図17は実開昭58-158475に示された電池駆動式電子機器用ケースである。図において、5は電子機器用ケース、11は電池ケースである。この図において、電池ケース11は前述した図16 20と同様に電子機器用ケースの表面、裏面、側面、底面を形成すると同時にその表面、裏面、側面、底面に囲まれた内部全てが電池である点で前述した実施例とは異なるものである。

【0030】また、図18は実開平3-76に示された 従来の電子機器筐体構造を示す図である。図において、 5は電子機器の筐体、11は電池カバーである。この図 18に示した例においても、電池カバー11は電子機器 の筐体の一部を形成しているとともに、この電池カバー の内部には電池が存在しており、図16、図17に述べ 30 たように電池カバーの内部が電池で満たされており、こ の例においてもこの発明で述べた実施例とは異なるもの である。

【0031】以上のように第2の発明が特に特徴としているところは電池自身あるいは電池を内蔵したパッテリユニット自身が筐体の面を形成している点であり、パッテリ自身をあるいはパッテリユニット自身を薄板状あるいは平型状に形成したことにより、筐体の一部をそのパッテリユニットで置き換えてしまうところに特徴があるものである。このように薄板状のパッテリを用いること 40により、従来、筐体の内部あるいは筐体の内部の一部分の相当な空間を占めていたパッテリ空間を他の部品により有効に使用することが可能となるものである。

[0032]

【発明の効果】以上のように、第1の発明によれば、従来の記録装置と同一外形寸法の装置でありながら、内部ユニット構成を自由に選択接続することで、種々の記録装置を構成でき、使用業務に合わせて各ユニットを増設又は変更しながらシステムアップ、システム変更が容易に行えるという効果がある。

【0033】以上のように、第2の発明によればパッテリユニットを背面カバー等の代わり、すなわち管体の一部として兼用することが可能となるため電子機器内の他の実装部品に対する影響が少なくなるという効果がある。すなわち限られたサイズにおいて他の実装部品のために使用できる領域がおおく取れる電子機器を得られるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施例による半導体ディスクの装 置構成図。

【図2】この発明の一実施例による半導体ディスクの回路プロック図。

【図3】この発明の一実施例による半導体ディスクのスロットのピン配置の一部の例を示す図。

【図4】この発明の一実施例による半導体ディスクの装 置構成例を示す図。

【図5】この発明の一実施例による半導体ディスクの別の装置構成例を示す図。

【図 6】この発明の一実施例による半導体ディスクの別 の装置構成例を示す図。

【図7】この発明の一実施例による半導体ディスクの装 置構成図。

【図8】この発明の他の実施例による半導体ディスクの 装置構成図。

【図9】この発明の一実施例による半導体ディスクの装 置構成図。

【図10】従来の半導体ディスクの装置構成図。

【図11】従来の半導体ディスクの回路プロック図。

【図12】従来の半導体ディスクの装置構成図。

【図13】従来の半導体ディスクの装置構成図。

【図14】従来の半導体ディスクの装置構成図。

【図15】従来の電子機器の筐体を示す図。

【図16】従来の携帯用無線機の構成を示す図。

【図17】従来の電池駆動式電子機器用ケースを示す 図。

【図18】従来の電子機器の筐体構造を示す図。 【符号の説明】

- 1 半導体メモリ
- 2 3.5 吋磁気ディスク装置
- 0 3 パッテリ
 - 4 周辺回路部
 - 5 筐体/本体
 - 6 バックポード
 - 7 コネクタ
 - 8 制御ユニット
 - 9 半導体メモリユニット
 - 10 HDDパックアップユニット
 - 11 パッテリユニット
 - 12 マイクロプロセッサ
- 50 13 ユニット識別回路

14 インタフェース回路

15 読みだし・書き込み回路

23 外部電源供給コネクタ

24 パッテリユニット固定用凸部

25 パッテリユニット側係合コネクタ

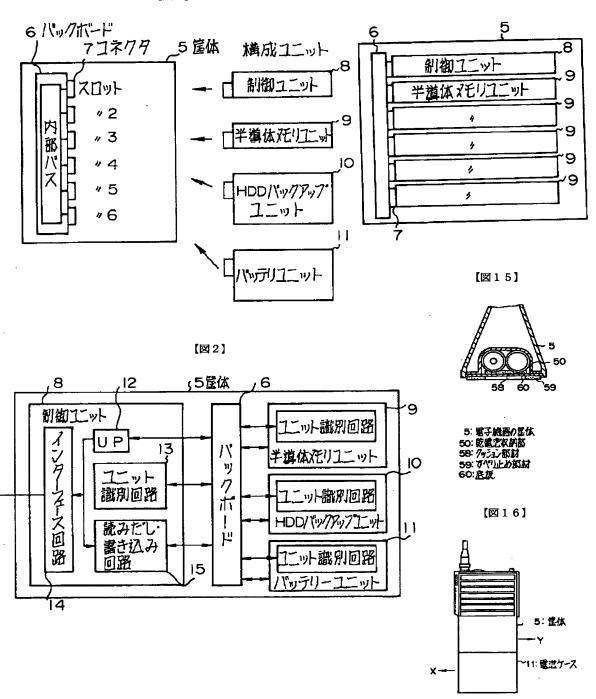
10

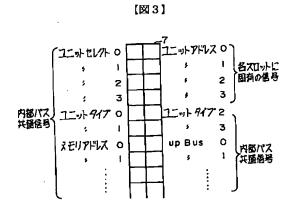
26 電池

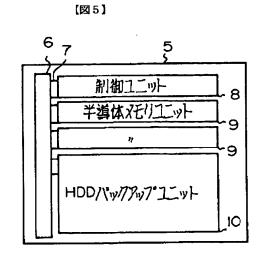
27 本体内実装部品

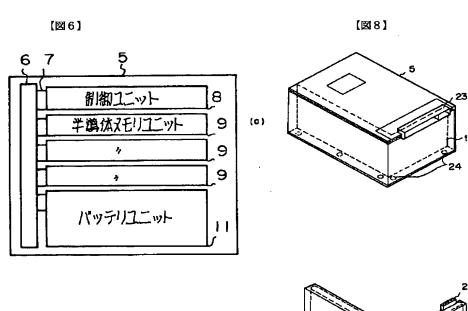
28 本体側係合コネクタ

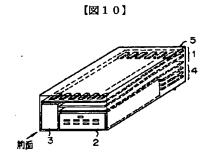
[図1] [図4]

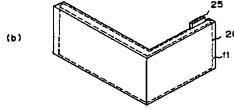


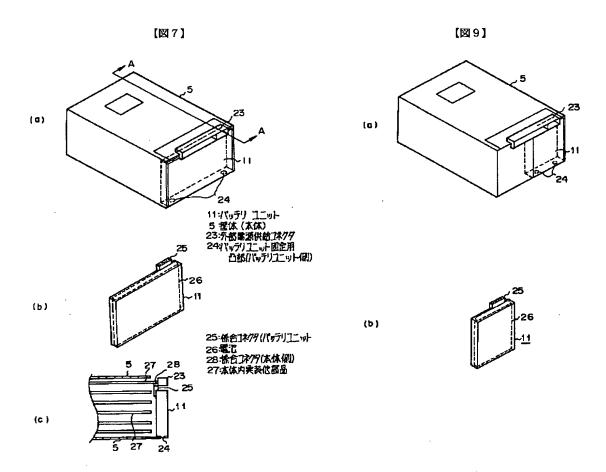




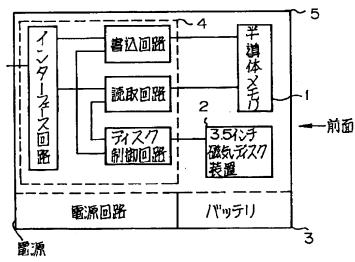




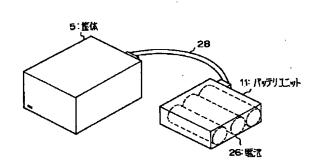




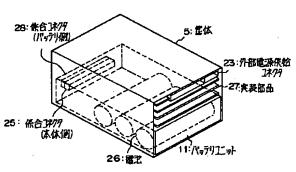
【図11】



【図12】

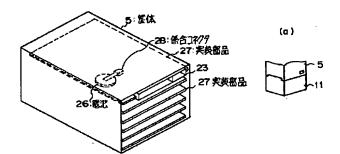


【図13】



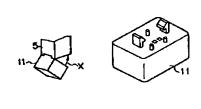
28パッテリーユニット接続ケーアル

【図14】



【図17】

(b)



(c)

【図18】

